

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2016-032

南通富士通微电子股份有限公司
关于收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85% 股权
完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的国际影响力及行业地位，进一步掌握高端封装测试技术，提升公司的盈利能力，在国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“产业基金”）的大力扶持下，根据公司与 Advanced Micro Devices, Inc.（以下简称“AMD”）签订的《股权购买协议》，以及公司与产业基金签署的《共同投资协议》的约定，由公司与产业基金分别向南通富润达投资有限公司（以下简称“富润达”）和南通通润达投资有限公司（以下简称“通润达”）进行增资，公司和产业基金分别持有富润达 50.52% 和 49.48% 的股权，富润达与产业基金将分别持有通润达 52.37% 和 47.63% 的股权。由通润达收购超威半导体技术（中国）有限公司（以下简称“AMD 苏州”）85% 的股权；同时，由通润达在香港投资的全资子公司钜天投资有限公司收购 Advanced Micro Devices Export Sdn. Berhad（以下简称“AMD 槟城”）85% 的股权（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司“2015-063”及“2016-010”公告）。

截至 2016 年 4 月 29 日，本次交易已完成了《股权购买协议》约定的各项交割工作。公司正按照既定计划有序开展各项交接工作，并将依照《南通富士通微电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》实施各项整合措施。

AMD 作为世界领先的半导体芯片提供商，拥有世界先进的倒装芯片封测技术，主要产品应用于电脑、服务器、高端游戏主机、云计算中心等高端领域，与公司自主研发的适用于通信及消费市场的倒装芯片封测技术形成互补，将显著提升公司倒装芯片封测技术，使公司在倒装芯片封测领域的技术达到世界一流水平，

提供封装品种最为完整的倒装芯片封测服务；AMD 这些技术与公司已经在规模量产的 Bumping（凸点制造）技术相配合，将显著提升公司在高端封测领域的服务能力和竞争力，也使公司能够更好的支持国产 CPU、GPU、网关服务器、基站处理器、FPGA（现场可编程门阵列）等产品的研发和量产。

本次交易完成后，AMD 苏州及 AMD 槟城公司将作为 AMD 主要的封测供应商，继续为 AMD 提供高质量的先进封测服务。同时，公司将充分利用 AMD 先进的技术、稳定的品质、成熟的团队，充分利用这个成熟的、大规模量产的平台，为国内外有高端封测需求的客户提供规模化、个性化的先进封测服务。公司预计，未来先进封装测试的收入将占到公司收入的 70%以上，在全行业中处于领先地位。本次交易能够显著提升公司的封测技术水平，进一步扩大公司的生产规模，提高公司的盈利能力，使公司跻身世界一流封测企业的行列。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2016 年 4 月 29 日